证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2025-033

上海艾为电子技术股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

（二）前次募集资金的存放及管理情况

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至2025年06月30日止，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

开户机构	账号	初始存放金额（元）	截止日账户余额（元）	备注
招商银行上海分行营业部	121939323310888	-	-	已销户
招商银行上海分行营业部	121928744310666	-	996,517.32	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	-	26,496,530.46	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	-	25,759,353.58	
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	3,050,985,204.94	19,740,011.13	
上海银行闵行支行	03004644696	-	18,454,220.80	
上海银行闵行支行	03004644378	-	68,536.57	
中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	-	41,192,847.71	
上海银行闵行支行	03005501767	-	1,240,401.48	
中国银行上海市吴中路支行	446885714103	-	29,103,439.46	
招商银行上海分行营业部	121939323310118	-	-	
上海银行闵行支行	03005824825	-	3.02	
上海银行闵行支行	03005824795	-	0.61	
上海银行闵行支行	03005824817	-	9.41	
上海银行零星支行	03005824787	-	-	
招商银行上海分行营业部	121941213410012	-	3.42	
招商银行上海分行营业部	121939330310013	-	15.85	
招商银行上海分行营业部	121944966010017	-	3.71	
招商银行上海分行营业部	121945865310018	-	2.70	
招商银行上海分行营业部	121953529210020	-	0.33	
招商银行上海分行营业部	411910565110021	-	1.44	
招商银行上海分行营业部	121980045910022	-	8.75	
合计		3,050,985,204.94	163,051,907.75	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

鉴于募集资金投资项目“研发中心建设项目”公司已通过自有资金购置办公楼的方式完成了项目的研发和技术升级，并已达到预定的产品研发目标，公司将该项目结项。同时，由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位，公司将“研发中心建设项目结项后的剩余募集资金20,205万元用于“电子工程测试中心建设项目”。并将“电子工程测试中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延长至2026年3月。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于2021年10月29日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为271,352,274.98元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第4-10031号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为271,352,274.98元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币78,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2022年8月22日，公司已将暂时补充流动资金78,000万元全部归还。

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下、继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。

2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。

2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2024年8月15日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还至募集资金专户。

2024年8月16日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2025年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为57,100万元。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。

2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2024年8月15日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还至募集资金专户。

2024年8月16日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2025年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为57,100万元。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2024年8月16日，本公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2025年06月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为25,000万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	公司主体
申万证券	龙鼎定制1442期	50,000,000.00	2024-9-3	2025-7-28	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	20,000,000.00	2025-3-25	2025-7-21	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	30,000,000.00	2025-4-29	2025-7-28	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	25,000,000.00	2025-5-27	2025-8-25	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	65,000,000.00	2025-4-3	2025-7-30	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	14,000,000.00	2025-4-29	2025-7-28	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	25,000,000.00	2025-4-24	2025-7-23	上海艾为微电子技术有限公司
上海银行	结构性存款	21,000,000.00	2025-5-15	2025-8-13	上海艾为微电子技术有限公司
合计		250,000,000.00			

3、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额金额为216,550.68万元，占前次募集资金净额的比例为71.34%；募集资金节余金额为98,405.19万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额11,464.36万元，以及未到期结构性存款20,000.00万元、理财本金5,000.00万元），将继续用于募集资金投资项目。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年4月13日，本公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其行生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年5月11日，本公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

（六）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于补充流动资金（已取消）

2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民17,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。该议案已经2021年9月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年9月28日，公司自募集资金专户中合计转出17,000万元的超募资金用于永久补充流动资金。

2021年10月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》，同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管。公司独立董事与保荐机构就此事项均无异议。该议案已经2021年11月12日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。2021年11月15日，公司已将上述17,000万元退回至募集资金专户。

2、超募资金用于回购公司股份

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过180元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。公司已完成回购股份，已使用超募资金人民币100,044,003.51元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、募集资金使用过程中置换

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

4、其他募投项目调整

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加金资子公司上海芜为集成电路技术有限公司、上海芜为半导体技术有限公司、深圳芜为集成电路技术有限公司、合肥芜为集成电路技术有限公司、哈尔滨芜为微电子技术有限公司、大连芜为微电子技术有限公司、北京芜为微电子技术有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“高性能模拟芯片研发和产业化项目”及“发展与科技储备资金”的实施主体。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2025年6月30日，研发中心建设项目、电子工程测试中心建设项目和发展与科技储备资金不能直接产生效益；智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目和高性能模拟芯片研发和产业化项目尚在建设中，不单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2025年6月30日止，本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告于2025年7月27日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海艾为电子技术股份有限公司

2025年7月29日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	303,526.14	已累计使用募集资金总额：	216,550.68
		各年度使用募集资金总额：	216,550.68
变更用途的募集资金总额：	20,205.00	2021年：	43,217.72
变更用途的募集资金总额比例：6.66%		2022年：	52,623.59
		2023年：	35,705.06
		2024年：	51,177.13
		2025年1-6月：	33,827.18

投资项目				募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能音频芯片研发和产业化项目	智能音频芯片研发和产业化项目		44,164.59	44,164.59	41,298.56	44,164.59	44,164.59	41,298.56	-2,866.03	2025年8月
2	5G射频器件研发和产业化项目	5G射频器件研发和产业化项目		21,177.05	21,177.05	15,623.49	21,177.05	21,177.05	15,623.49	-5,553.56	2025年8月
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	马达驱动芯片研发和产业化项目		36,789.12	36,789.12	26,687.05	36,789.12	36,789.12	26,687.05	-10,102.07	2025年8月
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目		40,824.76	20,619.76	21,892.29	40,824.76	20,619.76	21,892.29	1,272.53	2023年10月
5	电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目		73,858.20	94,063.20	68,105.95	73,858.20	94,063.20	68,105.95	-25,957.25	2026年3月
6	发展与科技储备资金	发展与科技储备资金		30,000.00	30,000.00	17,668.27	30,000.00	30,000.00	17,668.27	-12,331.73	2025年8月
7	超募资金	超募资金		56,712.42	10,004.40	10,004.40	56,712.42	10,004.40	10,004.40		不适用
8	高性能模拟芯片研发和产业化项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目			46,708.02	15,270.68		46,708.02	15,270.68	-31,437.34	2026年6月

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	智能音频芯片研发和产业化项目	不适用	预计项目内部收益率为25.21%（税后）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G射频器件研发和产业化项目	不适用	预计项目内部收益率为24.04%（税后）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	不适用	预计项目内部收益率为26.66%（税后）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	电子工程测试中心建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	发展与科技储备资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	超募资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	高性能模拟芯片研发和产业化项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2025-034

上海艾为电子技术股份有限公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司于2025年7月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：

一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年7月29日

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2025-035

上海艾为电子技术股份有限公司关于部分募投项目子项目调整及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，提高募集资金使用效率，在募投项目金额不变的情况下，公司决定部分募投项目子项目调整及延期。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月4日出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,180万股，每股发行价格为76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述募集资金已于2021年8月10日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第4-00042号（验资报告）。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59
2	5G射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		246,813.72	246,813.72

公司分别于2023年4月13日、2023年5月11日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220.00万元及其行生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述新项目计划投资总额为47,747.45万元，拟使用剩余超募资金47,220万元及其行生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）
1	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00
合计		47,747.45	47,220.00

公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”结项后，公司拟将剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元，合计约20,183.60万元（具体金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”，并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准），募集资金承诺投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准）。公司于2023年12月5日进行了划拨，实际划拨金额为20,205.00万元，实际投资总额变更为94,063.20万元。

三、募集资金使用情况

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投入金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59	44,164.59	41,298.56
2	5G射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05	21,177.05	15,623.49
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12	36,789.12	26,687.05
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76	21,892.29	21,892.29
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20	94,063.20	68,105.95
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	17,668.27
7	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00	47,220.00	15,270.68
合计		294,561.17	294,033.72	295,306.25	206,546.28

注1：调整后使用募集资金投入金额包含首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

注2：上述累计投入金额为截至2025年6月30日数据。

四、本次部分募投项目子项目调整情况

（一）本次部分募投项目子项目调整的具体情况

1、公司“发展与科技储备资金”项目具体情况

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）
1	高压BCD先进工艺导入	6,500.00	6,500.00	6,679.89
2	基于RISC-V架构的SoC平台	4,800.00	4,800.00	-
3	电荷泵快充和光学防抖的技术开发	8,700.00	8,700.00	988.38
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		30,000.00	30,000.00	17,668.27

注：上述累计投入金额为截至2025年6月30日数据。

2、公司“发展与科技储备资金”项目子项目调整情况

公司拟将高压BCD先进工艺导入投资金额由6,500万元变更为14,000万元，基于RiscV架构的SoC平台投资金额由4,800万元变更为2,000万元，电荷泵快充和光学防抖的技术开发由8,700万元变更为4,000万元。“发展与科技储备资金”项目使用募集资金投资总额保持不变，具体调整情况如下：

序号	项目名称	调整前使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投入金额（万元）
1	高压BCD先进工艺导入	6,500.00	14,000.00
2	基于RISC-V架构的SoC平台	4,800.00	2,000.00
3	电荷泵快充和光学防抖的技术开发	8,700.00	4,000.00
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
合计		30,000.00	30,000.00

（二）本次部分募投项目子项目调整的原因

由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，因此拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整。

由于RISC V在手机端的应用生态尚未完全成熟，公司根据市场需求延后了RISC V架构开发计划，拟调低对基于RISC-V架构的SoC平台的投入。

由于市场竞争较为激烈，公司计划取消单芯片大功率电荷泵快充芯片的研发投入，因此，公司拟相应调低对电荷泵快充和光学防抖的技术开发的投入。

BCD工艺主要向着高压、高功率和高密度三个方向发展。公司涉及数模混合类的智能音频芯片和智能马达驱动芯片进行工艺升级，逐步导入90nm、55nm、40nm及更先进的BCD工艺。随着手机、工业、车载、物联网、AI等领域设备智能化趋势，以及其带来的消费体验提升，相应的对这些智能设备所需的模数混合类芯片的功能和性能要求也越来越高。音频功放、摄像头马达驱动、触觉反馈、电容检测等都属于数模混合类SoC芯片，集成了模拟的高压处理、和较大规模的数字电路，该部分芯片产品的市场空间将达到百亿元以上，未来规划高压BCD先进工艺导入，符合公司产品的发展趋势。目前，业内主流BCD工艺为0.18um BCD和90nm BCD工艺开发，对于大多数模拟及数模混合芯片来讲已满足其应用场景。在先进工艺BCD方面，55nm BCD和40nm BCD目前仍处于早期应用和开发阶段，是公司主要的研发投入方向。因此，随着公司工艺节点的不断演进，公司拟加大对高压BCD先进工艺导入的投入，以进一步升级和提升产品竞争力。

（三）本次部分募投项目子项目调整的可行性分析

近年来，公司在90nm BCD工艺的投入已实现了产品应用。公司具备完整的模拟、数字、后端、算法、软件开发团队及测试、验证、AE、FAE等平台和支持团队，项目负责人和核心技术人员具有丰富的工作经验且团队稳定，拥有多项相关应用技术、软件算法等专利，可以为研发提供技术保障。因此，公司加大对高压BCD先进工艺导入的研发投入具有可行性。

五、本次部分募投项目延期情况

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
发展与科技储备资金项目	2025年8月	2026年8月

（二）本次部分募投项目延期原因

由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对55nm和40nm BCD先进工艺导入的投入，根据对未来投入规划的测算，将募投项目延期至2026年8月，以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注产业发展方向及市场环境变化，结合公司实际情况，积极优化资源配置，合理统筹，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

（四）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

2025年7月27日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。

（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目子项目调整及延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理